再生医療に向けた足場材料の開発動向と評価

ES 細胞、iPS 細胞などの再生医療の研究が活発になってきている。生体内においては細胞が分化・増殖する場合、細胞外マトリックスが足場材料として機能し、組織の構築が重要である。これらの特性を満足する材料に、合成高分子(ポリグリコール酸、ポリ乳酸など)、天然高分子(コラーゲン、ゼラチンなど)、無機材料(ハイドロキシアパタイトなど)、およびこれらの複合体がこれまで検討されてきた。本セミナーでは足場材料の機能や評価について解説する。

開催日時 2014 年 5 月 26 日 (月) 10:30~16:10 受講料 4 8,600円 (税込) ※ 資料代、弁当代 含

【会場】

中央大学駿河台記念館 3F 350 会議室 〒101-8324 東京都千代田区神田駿河台 3-11-5

1. 再生医療のための高分子多孔質足場材料の基礎と新展開

講師	川添 直輝 氏 (独)物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 10:30~12:00(質疑含)					
	生体組織再生材料ユニットMANA研究者					
プログラム	1. 再生医療とティッシュエング: ア、ンゲ 上二、 生医療の現状と手に 2 ディッシュエン: ニテー・グによる再生医療の概念					
	1.3 ティッジュエンジニアリングしおけ 5 多 _ 質足場材料 ひ役割)					
	2. 多孔質足場材 だっぱい られる性性 機能 2.70 部価 (2.1 / 2.2 生体吸収性 2.2 生体吸収性 2. 2 生体吸収性 3. 2 生体吸収性 4. 2 生体促化 4. 4 生体促化					
	3. 高分子多孔質足場材料の一般的作製法(3.1 ポロゲン抽出法 3.2 凍結乾燥法 3.3 その他の方法/固体自由成形法・エレクトロ					
	スピニング法など)					
	4. 高分子多孔質足場材料の新展開(4.1空孔をパターンニングした高分子多孔質足場材料 4.2 合成高分子と天然高分子を複合化					
	した多孔質足場材料 4.3 細胞成長因子を導入した高分子多孔質足場材料)					
	5. 高分子多孔質足場を (1) た (1) た (1) た (1) (5.1 軟骨組織 (1.2 皮膚組織 (5.3 骨組織 (1.3 骨組織 (1.3 円組織 (
	6. まとめと今後の展					

講師都築 博彦氏富士フイルム㈱ R&D統括本部再生医療研究所(兼)技術戦略部13:00~14:30(質疑含)プログラム1. 富士フイルムとコラーゲン (ゼラチン) 技術

/ログブム | 2. 細胞培養基材への展開

3. 生体足場材料を目指した高分子ゲルの物性制御

講 師 **|酒井崇匡 氏** 東京大学大学院工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻 助教 | 14:40~16:10(質疑含)

- 1. 高分子ゲルの構造 (1.1 高分子ゲルのもつ不均一性 1.2 不均一性の起源 1.3 不均一性の物性へ及ぼす影響)
- 2. 均一網目構造を有するハイドロゲルの構造と特徴 (2.1構造 2.2ゲル化反応 2.3不均一性制御)
- 3. 高分子ゲルの物理特性 (3.1 応力ひずみ曲線 3.2弾性率 3.3破断エネルギー 3.4最大延伸倍率 3.5膨潤度 3.6 分解東度)
- 4. 弾性率 (4.1 弾性率を記述する 4.2 弾性率に及ぼす結合率の影響 4.3 弾性率に及ぼす架橋点間分子量・架橋点密度の影響 4.4 弾性率を記述するモデルの決定 4.5 制御可能な弾性率の範囲)

プログラム

- 5. 破断エネルギー(5.1 破断エネルギーを記述するモデル 5.2 破断エネルギーに及ぼす結合率の影響 5.3 破断エネルギーに及ぼす架橋点間分子量・架橋点密度の影響 5.4 エンハンスメントファクターの決定と分子論的意味付け 5.5 制御可能な破断エネルギーの範囲)
- 6. 最大延伸倍率 (6.1 最大延伸倍率を記述するモデル 6.2 最大延伸倍率に及ぼす結合率の影響 6.3 最大延伸倍率に及ぼす架橋 点間分子量・架橋点密度の影響 6.4 最大延伸倍率を記述する新たなモデルと分子論的意味付け 6.5 制御可能な最大延伸倍 率の範囲)
- 7. 膨潤度 (7.1 膨潤度を制御したゲルの作製 7.2 膨潤度を制御したゲルの力学特性)
- 8. 分解速度 (8.1 分解速度を制御したゲルの作製 8.2 分解速度を予測するモデル)
- 9. まとめ (9.1 各々の物性値の相関 9.2 ハイドロゲルの応用へ向けた問題点)

※プログラム充実のため内容が変更になることもあります。

弊社記入欄		セミナー申込書	(S&T 出版))			
セミナー名	再生医療に向けた足場材料の開発動向と評価						
	会社名(団体名) TEL:						
所定の事項に	住 所 〒	FAX :					
ご記入下さい	記入下さい E-mail:						
	部署	役職	氏 名				
お支払方法	(ご便宜の方法を○で囲んで	下さい。) 銀行振込・郵便振替	お支払予定	2013年	月	日頃	

■申込方法:セミナー申込書にご記入の上、FAXでお申し込みください。 折り返し、参加証、会場地図、請求書を送付いたします。

■申込先 : **何シーエムシー・リサーチ** 東京都千代田区神田錦町 2-7 TEL03-3293-7053

参加申込 FAX 番号 03-3291-5789